

0.5mm 间距 WQTH / WQSH系列
两排：40~180pin 配对合高：5.00~25.00mm



技术参数

绝缘材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电压：
触点：1.0A每针@30℃温升 接地板：7.8A每个接地板@30℃温升
工作温度范围：-55℃至+125℃
额定电压：175 VAC (5 mm 绝缘高度)
最大配接次数：100
SMT引线共面度：
(0.10 mm) .004"最大(030-060)
(0.15 mm) .006"最大(090)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可混装。

型号命名规则

WQTH	2 X	每排引脚数对数	引线式样	电镀选项	类型	A	选项	其他选项
30, 60, 90 (每列总共60个引脚=D)		20, 40, 60 (每列20对=DDP)	以图表中指定引线式样	F =信号引脚和接地板镀金膜，焊尾镀锡 L =信号引脚和接地板上镀10μ" (0.25 μm)的金，焊尾镀锡 C =可选电镀在触点区域的信号引脚上镀150μ" (3.81 μm)的锡，之上镀最少50μ" (1.27 μm)的金。在触点区域的接地板上镀50μ" (1.27 μm)的锡，之上镀最少10μ" (0.25 μm)的金。在所有焊尾上镀最少50μ" (1.27 μm)的锡，之上镀最少	D =单端 DDP =差分对(仅限H01)		K = (7.00 mm) .275" 直径的圆形连接器底座 L =锁扣选项(在H01插针式)在60 (DDP)和90上不可用	TR =带密封套 FR =金带和带(每带必须订货最大数量，请联系Worldpo)
							引线式样	配接高度
							H01	4.27 5.90
							H02	7.26 8.00
							H03	10.27 11.00
							H04	15.25 16.00
							H05	18.26 19.00
							H07	24.24 25.00
							H09	13.26 14.00
							加工条件将影响配接高度。	
WQSH	2 X	每排引脚数对数	H01	电镀选项	类型	A	选项	其他选项
30, 60, 90 (每列总共60个引脚=D)		20, 40, 60 (每列20对=DDP)		F =信号引脚和接地板镀金膜，焊尾镀锡 L =信号引脚和接地板上镀10μ" (0.25 μm)的金，焊尾镀锡 C =可选电镀在触点区域的信号引脚上镀150μ" (3.81 μm)的锡，之上镀最少50μ" (1.27 μm)的金。在触点区域的接地板上镀50μ" (1.27 μm)的锡，之上镀最少10μ" (0.25 μm)的金。在所有焊尾上镀最少50μ" (1.27 μm)的锡，之上镀最少	D =单端 DDP =差分对(仅限H01)		K = (7.00 mm) .275" 直径的圆形连接器底座 L =锁扣选项(在60 (DDP)和90上不可用)	TR =带密封套 FR =金带和带(每带必须订货最大数量，请联系Worldpo)